

LCP 马来西亚宝理 E130i-BK205P连接器专用LCP塑胶原料来电洽谈

产品名称	LCP 马来西亚宝理 E130i-BK205P连接器专用LCP塑胶原料来电洽谈
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶原料 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

9T塑胶材料会使用这类材料的连接器产品多为2.54间距贴片排母，和1.27间距/2.0间距系列排母。耐焊接温度在260度-300度左右，由于使用这种材料价格昂贵，一般是客户有特殊需求才会使用9T塑胶材料来生产连接器产品。

阻隔性能好 塑料对气体和水蒸气有极好的阻隔性，因此，可以用塑料制品各种容器、制品和薄膜，可起到很好的防水、防潮作用。

用液晶作成的纤维可以做鱼网、防弹服、体育用品、刹车片、光导纤维几显示材料等，还可制成薄膜，用于软质印刷线路、食品包装等。

由于拥有的粘合持久性和食品卫生性，在食品包装领域赢得了广大客户的信赖。由于引入的官能团的作用，针对聚烯烃的颜料、木粉等多种填料，Admer也可以起到偶联剂的效果，增加这些填料与聚烯烃的相容性。

具有良好的耐辐射照性和化学稳定性，故常用于原子能工业密封材料和仪表零部件。它可加工成形状复杂的制品，薄而口径大的管、薄片、薄膜、电线包皮、热收缩管和化工设备衬里等。

热致液晶聚合物还可与多种塑料制成聚合物共混材料，这些共混材料中液晶聚合物起到玻纤增强的作用，可以大大提高材料的强度、刚性及耐热性等。

POM具有明显的熔点，均聚POM为175、共聚POM为165。成型时，料筒温度的分布：前段190~200，中段180~190，后段150~180，喷嘴温度为170~180。对于薄壁制品，料筒温度可适当提高些，但不能超过210

减摩、耐磨性能好 大多数塑胶原料具有优良的减摩、耐磨和自润滑性能，它们既可以在水、腐蚀介质中正常工作，也可在边界摩擦和干摩擦条件下有效地工作，比金属要低很多，只有金属要好得多，通常

塑胶原料的摩擦系数，比金属要低得多，只有金属的几分之一到十几分之一，因此可用塑胶原料制作许多减摩和耐磨制品。

本公司品种，货源充足，产品原厂原包，，批量采购，原料可提供：MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。公司一贯秉承“良好的信誉，诚信的合作”方针；“客户至上，品质为本”是我们的准则；“为客户降低生产成本，”是我们努力的方向。因本公司品种繁多，只能提供部分型号供参考，如需其它型号请来电咨询洽谈！

模具温度通常控制在80~100℃，对薄壁长流程

ADMER QF300E是一种马来酸酐接枝、均聚聚丙烯（homo PP）基胶粘剂树脂，在与PP和PA的流延膜应用中具有良好的加工性能。

按照应用范围分主要有通用塑胶如PE/PP/PVC/PS等,工程塑胶如ABS/POM/PC/PA等常用的几种。另外还有一些特殊塑胶如耐高温高湿及耐腐蚀及其他一些为专门用途而改性制得的塑胶。

Admer，是由改性聚乙烯、改性聚丙烯组成的一种改性聚烯烃，由于在聚烯烃链上引入了粘合性官能团，使之在与EVOH等空气阻断树脂、金属、玻璃纤维、陶瓷等粘合时拥有特强的粘合性。通过共挤出成型，可以制作多层的片材、薄膜、管材、瓶材等多种制品。

力学性能好 塑胶原料的力学性能相对于金属要差些，但是塑料比金属要轻很多，因此按单位质量计算的强度（又称比强度）要接近或超过传统的金属材料，而某些塑胶原料，如玻璃钢的比强度比钢要高很多，因此，可以利用塑胶原料制作许多结构性构件。

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300℃，其电性能不受影响。间断使用温度可达316℃左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的

聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。